

天水华天科技股份有限公司 全资子公司项目投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

2014年6月27日，天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议审议通过了《关于全资子公司华天科技（西安）有限公司投资5.26亿元进行“FC+WB集成电路封装产业化项目”建设的议案》，同意全资子公司华天科技（西安）有限公司（以下简称“西安公司”）投资5.26亿元进行“FC+WB集成电路封装产业化项目”的建设。

本次投资属公司董事会审批权限，不需经过股东大会批准。

本次投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、项目基本情况

1、项目名称：FC+WB集成电路封装产业化

2、项目承办单位：华天科技（西安）有限公司

3、项目实施地点：西安经济技术开发区凤城五路105号

4、项目内容：本项目是在西安公司已掌握的FC+WB集成电路封装测试工艺技术的基础上，引进国际先进的集成电路封装测试设备、仪器805台（套），购置国内配套仪器、设备337台（套），建成一条具有国际先进水平的FC+WB集成电路封装测试生产线。

5、项目投资估算：本项目总投资52,600万元，其中固定资产投资50,254万元（含外汇6,334万美元），铺底流动资金2,346万元。

6、项目实施资金来源：西安公司自筹32,600万元、银行贷款20,000万元，外汇由西安公司自行购汇解决。

7、项目建设期：项目建设期共三年，项目建设采用分步分期的方式进行建设。

建设期第一年，主要进行建筑面积为 50544m² 的 2 号集成电路封装测试厂房方案设计、招标、建设以及交付使用。

建设期第二年，对集成电路封装测试设备、仪器进行考察，引进、购置并安装调试到位 60%，达到年封装 12000 万块的规模产能；完成生产大纲 48% 的产量，即 9600 万块，其中 FC 系列 2640 万块、BGA 系列 3840 万块、LGA 系列 1440 万块、QFN 系列 1200 万块、DFN 系列 480 万块。

建设期第三年，对集成电路封装测试设备、仪器进行考察，引进、购置并安装调试到位 100%，达到年封装 20000 万块的规模产能；完成生产大纲 80% 的产量，即 16000 万块，其中 FC 系列 4400 万块、BGA 系列 6400 万块、LGA 系列 2400 万块、QFN 系列 2000 万块、DFN 系列 800 万块。

8、项目预计达到的效益：项目完成后，年新增 FCBGA、FCCSP、FCPGA、BGA、LGA、QFN、DFN 系列集成电路先进封装测试能力 2 亿块。项目达产年与项目计算期平均年产生的经济效益如下表所示：

表 1-1 项目经济效益

序号	指标名称	单位	达产年	计算期平均
1	销售收入	万元	56,946	46,063
2	利润总额	万元	5,443	4,796
3	净利润	万元	4,627	4,077
4	销售税金	万元	3,453	2,793

9、可行性分析及前景

首先，项目是国家重点支持产业。集成电路产业作为国民经济和社会发展的战略性、基础性和先导性产业，是培育发展战略性新兴产业、推动信息化和工业化深度融合的核心与基础。我国始终高度关注和重视集成电路产业的发展，推出了《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）》（国发〔2005〕44号）、《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发〔2011〕4号）、《财政部 国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税〔2012〕27号）、《集成电路产业“十二五”发展规划》等一系列鼓励性政策，为集成电路产业的发展提供了良好的产业政策环境，促进集成电路产业的发展。

其次，项目实施是集成电路封装产业和技术的发展需要。全球集成电路产业快速发展的源动力来源于其制造技术的不断创新和发展，并且随着计算机、笔记本电脑、移动电话、便携式媒体播放器等产品的日益普及，人们对各类电子产品的功能要求越来越多、性能要求越来越强、体积日趋变小、重量日趋变轻，促使电子产品向多功能、高性能和小型化、轻型化方向发展。此外，国内三网融合、物联网、云计算、节能环保、高端装备为代表的战略性新兴产业的快速发展，对集成电路芯片设计、制造及封装测试提出了更高的要求，使得集成电路晶圆（芯片）特征尺寸越来越小，据半导体业界预测未来 2~3 年半导体产业将会进入 14 纳米时代，化合物半导体、SoC、低成本的铜引线键合、TSV、FC 等技术的发展将会成为当今半导体产业发展的强大驱动力。

第三，国内集成电路封装市场需求巨大。集成电路由于能广泛应用于计算机、汽车电子、消费类电子、网络通信等终端各个领域，对我国电子信息产业以及经济社会发展的支撑带动作用日渐明显。2013 年在移动互联网、三网融合、物联网、云计算、节能环保、高端装备为代表的战略性新兴产业等新应用领域的带动下，我国集成电路产业呈现加速增长的势头。根据我国《集成电路产业“十二五”发展规划》，到“十二五”末，集成电路产业规模将再翻一番以上，集成电路产量超过 1500 亿块，销售收入达 3300 亿元，年均增长 18%，占世界集成电路市场份额的 15%左右，满足国内近 30%的市场需求，未来几年我国集成电路产业发展前景仍然十分广阔。

三、投资对公司的影响

西安公司通过自主研发，已掌握了基于 FC+WB 核心关键封装技术，实现了 3G/LTE 手机、平板 AP 处理器、IPTV 处理器、多模基带等集成电路封装测试产品的量产导入，但由于规模封装测试的能力尚小，无法助力企业实现快速发展。通过该项目的实施，将会提高西安公司集成电路高端封装测试水平、扩大产能规模，延伸企业产业链，提高集成电路高端封装测试产品的国际国内市场占有率，快速响应客户需求，吸引高级技术和管理人才，增强公司的整体竞争实力。

四、项目实施的风险

1、经营风险：由于我国集成电路产业与发达国家相比，无论在技术上，还是在管理上，都存在较大差距。在经济全球一体化的今天，集成电路制造行业同其他行业一样面临着巨大挑战。随着国外集成电路产品逐步进入我国，对我国集成电路制造工业形成了挑战。我国集成电路行业的竞争优势目前主要还是在成本和价格方面，但随着时间的推移，这种优势会逐渐削弱。

2、管理风险：由于本项目是高技术产业，其核心技术对其关键技术人员的依赖性较大。在激烈的市场竞争中，人才竞争是其最大的竞争。如果关键技术人员的流失，就有可能对公司技术专利、技术诀窍和其它无形资产造成的泄露和散失的风险。

3、技术风险：集成电路先进封装技术是集微电子、计算机、机械加工、表面处理、注塑成型等技术于一体的技术。并且集成电路封装技术的发展趋势是向封装高密度、小体积方向发展，集成电路封装产品要有关键核心的制造工艺技术作为支撑，实施该项目存在一定的技术风险。

备查文件：

公司第四届董事会第十次会议决议

特此公告。

天水华天科技股份有限公司董事会

二〇一四年六月二十八日